КАРИМОВ А.В., ЁДГОРОВА Д.М.

инжекционно-полевой фотодиод

Предложен фотодиод на основе *p*AlInGaAs–*n*GaAs–*m*-переходов. Высокая фоточувствительность в нем достигается в режиме прямого смещения *p*–*n*-гетероперехода и запирания *n*–*m* перехода. В этом режиме освещение структуры из собственной или примесной области спектра приводит к уменьшению сопротивления базовой области за счет генерированных фотоносителей, что приводит к последующему увеличению инжекционного тока через прямо смещаемый *p*–*n*-переход. При этом с увеличением приложенного напряжения поле на запираемом *n*–*m*-переходе возрастает. Такие фотодиоды могут использоваться для регистрации оптического и лазерного излучений в диапазоне 0,8...1,6 мкм.

В настоящее время в оптико-электронных системах для приема лазерного излучения используются полупроводниковые фотодиоды на основе Si и полупроводниковых соединений A^3B^5 . Разработано несколько типов пороговых быстродействующих фотодиодов, в том числе со структурой p^+pn^+ , лавинные фотодиоды со структурой n^+ppn и другие [1]. Необходимый режим работы в них обеспечивается в условиях, близких к пробою, когда обратные токи сильно возрастают, в результате наблюдается смещение рабочей точки и нестабильности параметров. Коэффициент умножения сильно зависит как от интенсивности света, так и от напряжения, которое необходимо поддерживать с точностью 0,02% [2]. В случае структур с разделением областей поглощения и умножения имеют место большие туннельные токи при перекрытии области поглощения объемным зарядом обратно смещенного перехода [3].

Указанных недостатков лишены трехбарьерные фотодиодные структуры Au–nAlGaAs-pGaAs–Ag с внутренним усилением [4—6], которые также работоспособны при оптическом возбуждении с любой из сторон и при любой полярности рабочего напряжения [7]. К классу структур с внутренним усилением можно отнести предлагаемый в данной работе инжекционно-полевой фотодиод.

Фотодиод состоит из полупроводника с *p*–*n*-переходом с длинной базовой областью *n*GaAs. Область *p*-типа получена выращиванием из жидкой фазы эпитаксиального слоя *p*AlInGaAs(Zn) в виде микрослоев на подложках *n*GaAs, легированных кислородом. Толщина верхнего эпитаксиального слоя *p*AlInGaAs составляет ~1 мкм, а области *n*GaAs — 350 мкм. Концентрация носителей в эпитаксиальном слое *p*AlInGaAs(Zn) составляет $4 \cdot 10^{17}$ см⁻³, а в подложке $4 \cdot 10^{15}$ см⁻³. Со стороны пленки *p*AlInGaAs напылением в вакууме через маску нанесены омические контакты из Au+Zn, а с тыльной стороны подложки сформирован полупрозрачный (60...70 Å) выпрямляющий контакт из Ag. Таким образом, структура имеет два выпрямляющих перехода, один гетеро